

[KAIST ME 산학협동 공개강좌] 반도체 첨단패키징을 위한 공정 소재, 역학 및 측정기술의 이해와 응용



참가신청서

일시 : 2025.02.03 (월) ~ 06 (목) / 장소 : KAIST 기계공학동 대회의실 (N7 1601호)

* 강좌 설명

본 강좌는 반도체 첨단패키징에서 활용되는 공정, 분석 및 측정 기술에 대한 핵심 원리와 응용방법을 다루는 강좌로 반도체 패키징 설계 및 생산에 필요한 기초 역학 이론을 학습하고, 반도체 패키징 분야의 고도화와 첨단화를 주도하기 위한 공학적 사고 능력을 갖추도록 하는 것을 목표로 함.

* 신청 기간 : ~2025.01.16 (목) 자정

* 수강 정원 : 80명 (정원 마감 시 조기 마감)

* 수강 신청

상단 QR 코드 또는 <https://buly.kr/5fBJaxZ> 으로 접속하여 참가 신청서 제출

* 강사진 : 카이스트 기계공학과 교수 12명



윤용진 교수 - 증착



김산하 교수 - CMP



남동욱 교수 - 하이브리드본딩



김지태 교수 - 3D 배선



김성수 교수 - EMC 경화



김택수 교수 - 박막 신뢰성



김형수 교수 - 미세 유체



남영석 교수 - 열관리



이정철 교수 - 신공정 & 측정



오왕열 교수 - 광학 측정



김영진 교수 - 비파괴 측정



노민균 교수 - 정밀 스테이지

* 수강 대상

산업체, 연구소 및 대학에서 패키징과 관련된 공정, 측정 및 평가 기술의 고도화 및 첨단화에 관심이 있는 자.

* 수강료: 교재비, 증식비 포함

| | |
|--------------|-------------------------|
| 일반 (4일 / 2일) | 1,000,000 원 / 600,000 원 |
| 학생 (4일 / 2일) | 500,000 원 / 300,000 원 |

* 수강료 납부 방법: 계좌이체, 신용카드, 산학기금 계정대체

1) 계좌이체 (2025년 01월 01일 이후 입금 가능)

- 계좌번호: 우리은행 270-003359-13-137 (한국과학기술원)
- 입금 후 성명/소속명/연락처를 scott@kaist.ac.kr 로 전달

2) 신용카드

- 강좌 당일 카드결제 가능

* 학생 : 재학증명서 사본 제출

* 수익 사업으로 계산서 교부 가능

* 강좌 일정

| 강의 일자 | 강의 주제 | 강사진 |
|-------------|--|----------------------------|
| 1일자 (02.03) | 증착 CMP 하이브리드 본딩 공정 | 윤용진 교수 김산하 교수 남동욱 교수 |
| 2일자 (02.04) | 3D 배선 인쇄 EMC 경화 공정 박막 신뢰성 평가 기술 | 김지태 교수 김성수 교수 김택수 교수 |
| 3일자 (02.05) | 미세 유체역학 제어 솔루션 열관리 공정/측정 신기술 | 김형수 교수 남영석 교수 이정철 교수 |
| 4일자 (02.06) | 3차원 초고속 광학 측정 비파괴 측정/검사 정밀 모션 스테이지 | 오왕열 교수 김영진 교수 노민균 교수 |

KAIST



문의 : KAIST 김산하 교수
(sanhkim@kaist.ac.kr)